

BPCAL03

-20°C~60°Cの環境に対応 そのうえファンレス・高性能

ハイブリッドコアアーキテクチャを採用した最新CPUを搭載。厚みのある堅牢なきょう体と大型ヒートシンクにより、ファンレス動作と高い耐久性を実現しています。-20°Cから60°Cまでの幅広い温度環境で安定稼働が可能です。また、搭載インターフェースはニーズに応じたカスタマイズにも対応。KIOSK端末や券売機、産業用ロボット、エッジコンピューティングデバイス、デジタルサイネージなど、多岐にわたる用途で革新的なソリューションを生み出します。



第12世代Intel Core プロセッサを搭載 高いパフォーマンスと省電力を両立

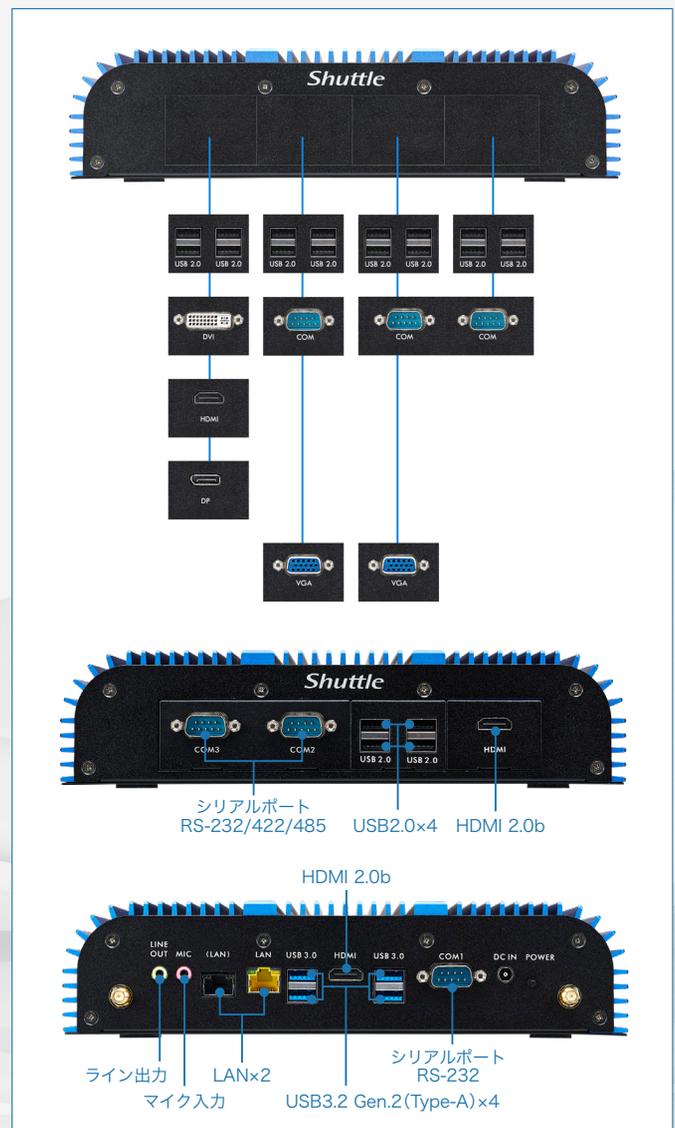
開発コード名Alder Lakeの第12世代Intel Core プロセッサを搭載しています。高性能コア(Pコア)と高効率コア(Eコア)を組み合わせた「パフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャー」を新たに採用。DDR5メモリーにも対応し、次世代の高速データ転送を実現。従来とは一線を画す、高いパフォーマンスと省電力を両立させたプロセッサです。

小型・ファンレス・広い動作温度 設置場所を選ばず使える

外形寸法が幅245×奥行169×高さ57mmとコンパクト。そのうえファンレス仕様でストレージにSSDを採用しているため、動作音はほぼ無音です。-20°Cから60°Cまでの幅広い温度環境に対応しており、さまざまな場所で安心して使用できます。

豊富なインターフェース カスタマイズにも対応

USB 3.2 Gen2×4 やGigabit Ethernet×2、HDMI×2と現在主流となっているインターフェースはもちろん、シリアルポートも備えており、バーコードリーダーなど産業用のさまざまな周辺機器を接続できます。また、お客さまのニーズに合わせて柔軟なカスタマイズに対応しているのもBPCAL03の大きな特徴です。



スリム型ファンレスコンピュータ

BPCAL03

製品名	BPCAL03
ベースとなるペアボーン	BPCAL03
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Core™i3-1215UE/インテル® Core™ i5-1245UE
メモリー (選択可)	DDR5 8GB So-DIMM ×1/DDR5 16GB So-DIMM ×1/ DDR5 8GB So-DIMM ×2/DDR5 16GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
オーディオ	Realtek ALC888s-VD 2チャンネル
ネットワーク	インテル®2.5ギガビットLAN×2、Wake-On-Lan(WOL)
無線LAN	オプションにて対応
Bluetooth	オプションにて対応
電源	150W ACアダプター
ファンレス	対応
マウント	VESAマウント(75mm×75mm)、Earマウント(256mm×100mm)、DINレール(35mm)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、サーマルパッドセット
外形寸法	幅245奥行き169×高さ57mm
重量	2.85kg

■ 入出力端子

映像端子	HDMI×2 ※オプションにて変更可	
外部接続端子(前面)	USB	USB 2.0×4 ※オプションにて変更可
	COMポート	2(RS232/RS422/RS485)4 ※オプションにて変更可
	オーディオ	非搭載
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen2(Type A)×4
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	1(RS-232)
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)	
ケンジントンロック	非搭載	

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

